

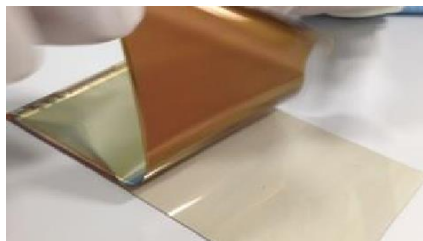
LLOラボキット



実験用固体UVレーザーLLO装置 LSL-10

応用

フレキシブルディスプレイ工程、LED製造、極薄シリコンウエハ工程において形成されたデバイスを基板の裏からレーザにより剥離するレーザーリフトオフ・プロセス(LLO)が使われるようになってきました。アブレーション加工出来る材質であればガラス基板や有機フィルムなどレーザー光を透過する基板を用いてレーザ照射により瞬間的に界面の剥離が可能のため、用途が急速に広がっています。



フレキシブルディスプレイ



極薄シリコンウエハ



有機半導体

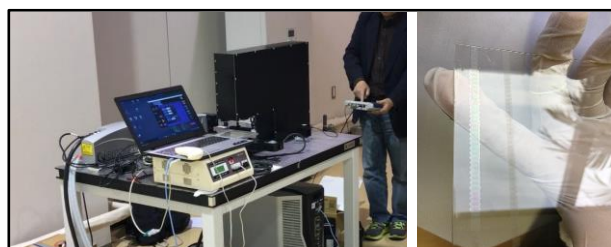
装置の特徴

本装置は固体UVパルスレーザーを用いて弊社独自の光学設計により均一ラインビームを基板に照射し、ワークをステージで動かすことにより基板全面にLLOプロセスを行うための実験装置です。

1. 小型・低価格
2. 電源のみで使用できます。
3. オプションでレーザーフィルムカット機能

仕様

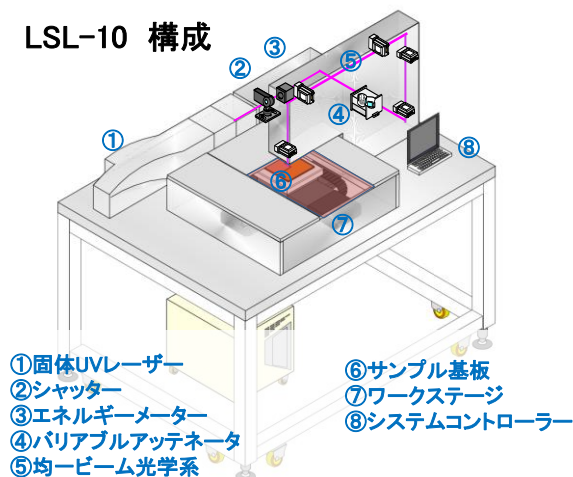
波長	355nm
ラインビームサイズ	10mm x 1mm
照射エネルギー密度	40~400mJ/cm ² (パリアブルアッテネータ)
ビームオーバーラップ	0%~98% (ステージ制御)
ワークサイズ(mm)	最大150 x 150 オプション: G2(370 x 470)
処理能力	5分 (100mm角パネル)
ステージストローク	200mm x 200mm
装置サイズ (mm)	L1200 x W900 x H1300
ユーティリティ	AC100V ±10% 15A



LSL-10による実験

剥離面(一列)

LSL-10 構成



注意: 本装置はLLOプロセス実験のためのラボキットです。レーザー管理区域内で御使用下さい。ワークの遮光はオプションとなります。

